

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2020-007

广东惠伦晶体科技股份有限公司
2019 年度业绩预告暨减值风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-12,500.00 万元— -12,000.00 万元	亏损：2,229.44 万元

风险提示：结合公司实际经营情况及行业市场变化等影响，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司拟对商誉、固定资产及存货等资产计提减值准备，其中商誉减值 4,000 万-4,500 万，设备减值 3,500 万-4,000 万，存货减值 1,100 万-1,400 万。目前相关资产减值测试工作尚在进行中，最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构确定。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、战略优化和经营策略调整，导致短期内费用上升。

(1) 2019 年公司应对中美贸易摩擦所带来的影响，加大了公司在国内营销网络的建设，分别在深圳、成都和上海建立销售机构，提高公司在国内市场上的份额，并取得了良好的成效。

(2) 为保持公司在国内同行的领先地位，抢占 5G 商用化的先机，不断提高公司产品市场竞争力，公司引进新的技术团队，加快了对新产品、新技术、新工艺的研究开发，研发费用有较大幅度的提高。

2、计提资产减值准备。

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性

原则，公司拟对商誉、固定资产及存货等资产计提资产减值准备，且资产减值金额较大。尽管自 2019 年第 3 季度以来上述战略优化和经营策略调整取得良好的成效，下游市场逐渐回暖，公司订单明显增加，但预计仍不足以抵消计提资产减值对公司业绩的影响。

3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 358 万元。

四、其他相关说明

1、公司当前整体经营情况正常。随着国内 5G 建设的提速及消费电子领域需求的稳步复苏，市场对小型化晶体元器件的需求持续增加，公司相关产品的销售呈现良好态势，且在产品的小型化等技术层面仍然保持国内领先地位。

2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日